

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2026-010

聚辰半导体股份有限公司

2025 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告所载为准，提请投资者注意投资风险。

一、年度主要财务数据和指标

单位：元 币种：人民币

主要财务数据和指标	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
营业总收入	1,220,918,812.98	1,028,277,491.86	18.73
营业利润	379,282,177.77	302,412,965.23	25.42
利润总额	379,238,154.74	298,570,021.41	27.02
归属于母公司所有者的净利润	362,871,439.70	290,269,536.29	25.01
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	329,917,352.79	263,916,243.79	25.01
基本每股收益（元）	2.30	1.84	25.00
加权平均净资产收益率（%）	15.29	14.02	增长 1.27 个百分点
主要财务数据和指标	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	2,678,286,286.09	2,305,315,811.94	16.18
归属于母公司的所有者权益	2,555,735,484.47	2,204,971,727.21	15.91
股本	158,271,044.00	157,718,544.00	0.35
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	16.15	13.98	15.52

注：以上数据均为未经审计的合并报表数据，本报告期初数同法定披露的上年年末数。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司各下游应用市场需求结构分化明显，部分产品线的市场销售

情况呈现较大幅度波动。受益于近年来持续完善在高附加值市场的产品布局，并不断加强对新产品的推广、销售及综合服务力度，公司 DDR5 SPD 芯片、汽车级 EEPROM 芯片和高性能工业级 EEPROM 芯片的出货量较上年同期实现快速增长，光学防抖式（OIS）摄像头马达驱动芯片搭载在主流智能手机品牌的多款中高端机型实现商用，产品销售结构得到进一步优化，带动公司综合毛利率较上年同期增加 2.46 个百分点，较好缓解了部分下游应用市场需求波动带来的影响，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力。公司全年实现营业收入 122,091.88 万元，归属于母公司所有者的净利润为 36,287.14 万元，分别较上年同期增长 18.73%和 25.01%，均创历史同期最好成绩。

与此同时，公司持续提升研发水平，全年研发投入达 20,899.53 万元，同比增长 19.01%，为历史同期最高水平。报告期内，公司凭借领先的研发能力，与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商合作，率先推出配套下一代高性能存储设备的 VPD 芯片，用于提供关键参数管理、设备识别及系统级校验能力，成为首家进入设计验证阶段、支持该公司新一代企业级固态硬盘模组和 CXL 内存扩展模组的 VPD 开发商。此外，为提升在汽车电子和高性能工业应用领域的市场竞争力，公司不断通过工艺提升和设计优化进行产品的技术升级，快速拓展并完善在前述领域的产品布局，所开发的系列高可靠性存储芯片已广泛应用于全球前 20 大中的 16 大以及国内前 20 大的全部汽车品牌的核心元器件，产品的销量和收入占公司整体业务的比重快速提升，进一步丰富了公司的业务结构。

三、风险提示

本公告所载 2025 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2025 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据应以公司经审计后正式披露的 2025 年年度报告所载为准，敬请投资者注意风险，理性投资。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日